

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號： 1347

新聞稿

華虹半導體二零一五年第四季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2016年2月2日 — 全球領先的200mm純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一五年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一五年第四季度主要財務指標 (未經審核)

- 銷售額 1.394 億美元，環比下降 19.1%，同比下降 16.1%。
- 毛利率 29.5%，環比下降 1.1 個百分點，同比上升 0.4 個百分點。
- 淨利潤 2,090 萬美元，環比下降 31.0%，同比增長 8.9%。

二零一五年度 (未經審核)

- 銷售額 6.501 億美元，較上年度下降 2.2%。
- 毛利率 31.0%，較上年度上升 1.2 個百分點。
- 淨利潤 1.124 億美元，較上年度上升 20.7%。
- 每股盈利 0.11 美元，與上年度持平。

二零一六年第一季度指引

- 我們預計銷售額環比增長 14%~16%。
- 此外，毛利率預計在 28%至 30%之間。

二零一五年度股利派發

- 公司將在二零一六年五月召開二零一五年度股東大會時根據已公佈的股利政策（計畫連續三年所派股息的平均額將不低於該三年平均可分配淨利潤的 30%）決定股利分配方案。

本公司總裁兼執行董事王煜先生表示：

“由於一廠和三廠的年度檢修以及市場的季節性疲軟，二零一五年第四季度的銷售額環比下降 19.1%，至 1.394 億美元；毛利率下降 1.1 個百分點，至 29.5%；淨利潤下降 31.0%，至 2,090 萬美元。但與去年同期相比，毛利率增長 0.4 個百分點，淨利潤增加 8.9%。”

關於未來，王煜先生繼續說道，“我們預計所有技術平臺產品的銷售額都將在二零一六年第一季度反彈。儘管全球經濟前景仍然疲軟，但我們確信，公司將在二零一六年有適度的增長。我們對於全球半導體市場的長期發展十分有信心，尤其是在中國。我們堅信，作為領先的集成電路製造企業，我們將在此獲益。因此，我們將繼續按照計劃擴充產能。”

“最後，並且非常重要，”總裁先生總結道，“我們的 90 納米嵌入式快閃記憶體工藝平臺和領先的超級結解決方案已經就緒，我們預計今年將有更多產品會遷移到這些技術上來。這將在成本和技術競爭力方面為公司帶來巨大收益。”

電話會議公告

日期：二零一六年二月三日

時間：上海時間下午三時

廣播：該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php 或

https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2015_q4_earnings_call

電話詳細：	國際	+65 6713 5521
	中國	+86 800 870 0531/+86 400 624 0406
	香港	+852 3018 6768
	臺灣	+886 2 7703 1751
	美國	+1 347 549 4095

電話會議登入名： 31800869

密碼： HUAHONG

該電話會議廣播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都將在本新聞稿廣播後 12 個月內刊登於華虹半導體的網站上。

關於華虹半導體

本公司是一家全球領先的 200mm 純晶圓代工廠。本公司在上海設有三家晶圓廠，主要專注製造特種應用的晶圓半導體。本公司生產的半導體被廣泛應用於不同市場的各類產品，主要包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車等。本公司採用自身的專有工藝及技術，為多元化客戶製造符合其設計規格的半導體，本公司亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製成品率各方面均達致最優的複雜設計。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>

經營業績概要
(以千美元為單位，每股盈利和營運數據除外)

	二零一五年 第四季度 (未經審核)	二零一五年 第三季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第四季度 (未經審核)	同比	二零一五 年度 (未經審核)	二零一四 年度 (已審核)
銷售收入	139,402	172,357	(19.1)%	166,129	(16.1)%	650,131	664,586
銷售成本	(98,290)	(119,681)	(17.9)%	(117,730)	(16.5)%	(448,705)	(466,815)
毛利	41,112	52,676	(22.0)%	48,399	(15.1)%	201,426	197,771
毛利率	29.5 %	30.6 %	(1.1)%	29.1 %	0.4 %	31.0%	29.8 %
經營開支	(29,968)	(28,032)	6.9 %	(26,045)	15.1 %	(112,147)	(92,259)
其他收入淨額	14,244	9,602	48.3 %	3,038	368.9 %	35,794	15,300
稅前溢利	25,388	34,246	(25.9)%	25,392	- %	125,073	120,812
所得稅開支	(4,522)	(4,015)	12.6 %	(6,240)	(27.5)%	(12,687)	(27,722)
期/年內溢利	20,866	30,231	(31.0)%	19,152	8.9 %	112,386	93,090
以下各方應佔利潤：							
母公司擁有人	20,866	30,231	(31.0)%	19,152	8.9 %	112,386	93,090
非控制權益	-	-	-	-	-	-	-
持有人應佔每股盈利：							
基本	0.02	0.03	(33.3)%	0.02	-	0.11	0.11
攤薄	0.02	0.03	(33.3)%	0.02	-	0.11	0.11
付運晶圓(仟片)	332	384	(13.5)%	343	(3.2)%	1,442	1,402
產能利用率 ¹	80.3 %	90.4 %	(10.1)%	93.3 %	(13.0)%	90.0%	93.5%

二零一五年第四季度 (未經審核)

- 銷售額 1.394 億美元，環比下降 19.1%，同比下降 16.1%。
- 銷售成本 9,830 萬美元，環比下降 17.9%，同比下降 16.5%，主要由於晶圓銷售量下降所致。
- 毛利率 29.5%，環比下降 1.1 個百分點，主要由於工廠年度維護等原因導致產能利用率下降所致，部分被折舊費用減少和存貨跌價準備轉回的影響所抵消。
- 經營開支 3,000 萬美元，較上季度的 2,800 萬美元上升了 6.9%，主要由於本期計提年終獎金所致。
- 其他收入淨額 1,420 萬美元，環比增加 48.3%，主要由於本期獲得較多的研發資助及財務費用下降所致，部分被匯兌收益和利息收入下降的影響所抵消。
- 所得稅開支 450 萬美元，環比增加 12.6%，主要由於上季度轉回 240 萬美元股利分配代扣代繳稅金所致。
- 期內溢利 2,090 萬美元，環比下降 31.0%，同比增長 8.9%。

¹ 產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算

二零一五年度 (未經審核)

- 銷售額 6.501 億美元，較上年度下降 2.2%，主要由於二零一五年下半年客戶需求減少所致。
- 毛利率 31.0%，較上年度上升 1.2 個百分點，主要由於折舊和攤銷費用下降所致。
- 經營開支 1.121 億美元，較上年度的 9,230 萬美元增加了 21.6%，主要由於人員費用和研發費用增加所致。
- 其他收入，淨額 3,580 萬美元，較上年度增加 2,050 萬美元，主要由於本年度獲得的研發資助和匯兌收益增加以及財務費用減少所致。
- 所得稅開支 1,270 萬美元，較上年度減少了 1,500 萬美元，主要由於 1)公司根據公佈的股利分配政策，對二零一三年第四季度及二零一四年度已計提的代扣代繳稅金予以轉回；2)公司於二零一五年獲批股利分配代扣代繳稅金的優惠稅率（5%）。
- 年內溢利 1.124 億美元，較上年度上升 20.7%。
- 每股盈利 0.11 美元，與上年度持平。

銷售收入分析

按類別劃分的銷售收入	二零一五年 第四季度 (未經審核)	二零一五年 第三季度 (未經審核)	二零一四年 第四季度 (未經審核)
晶圓	97.3%	96.9%	95.7%
其他	2.7%	3.1%	4.3%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 本季度 97.3% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的銷售收入	二零一五年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第四季度 % (未經審核)	二零一五年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 百分點
中國 ²	75,165	53.9%	93,272	54.1%	(18,107)	(0.2)
美國	27,415	19.7%	32,893	19.1%	(5,478)	0.6
歐洲	15,011	10.8%	17,413	10.1%	(2,402)	0.7
亞洲 ³	11,555	8.2%	13,301	7.7%	(1,746)	0.5
日本 ⁴	10,255	7.4%	15,477	9.0%	(5,222)	(1.6)
銷售收入總額	139,402	100.0%	172,357	100.0%	(32,955)	-

- 中國區域仍是我們最大的市場，本季度其貢獻的銷售收入占總銷售收入的 53.9%，與上季度基本持平。從絕對金額來看，本季度來自於中國區域的銷售收入較上季度下降了 1,810 萬美元，主要由於一些客戶對智能卡芯片及電源管理芯片的需求下降所致。
- 本季度美國區域的銷售收入占總銷售收入的 19.7%，與上季度基本持平。從絕對金額來看，本季度來自於美國區域的銷售收入較上季度下降了 550 萬美元，主要由於一些客戶對分立器件及電源管理芯片的需求下降所致。
- 本季度歐洲區域的銷售收入占總銷售收入的 10.8%，與上季度基本持平。從絕對金額來看，本季度來自於歐洲區域的銷售收入較上季度下降了 240 萬美元，主要由於一些客戶對智能卡芯片的需求下降所致。
- 本季度日本區域的銷售收入占總銷售收入比重比上季度下降了 1.6 個百分點，主要由於一些客戶對微控制器和邏輯產品的需求下降所致。

²包括香港。

³不包括中國及日本。

⁴包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一名主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的銷售收入	二零一五年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第四季度 % (未經審核)	二零一五年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 百分點
嵌入式非易失性存儲器	58,869	42.2%	76,075	44.1%	(17,206)	(1.9)
分立器件	37,886	27.2%	39,267	22.8%	(1,381)	4.4
模擬與電源管理	21,166	15.2%	27,111	15.7%	(5,945)	(0.5)
邏輯及射頻	14,217	10.2%	21,295	12.4%	(7,078)	(2.2)
獨立非易失性存儲器	6,724	4.8%	8,259	4.8%	(1,535)	-
其他	539	0.4%	350	0.2%	189	0.2
銷售收入總額	139,402	100.0%	172,357	100.0%	(32,955)	-

- 本季度來自於嵌入式非易失性存儲器的銷售收入占總銷售收入的 42.2%，環比下降 1.9 個百分點，主要由於微控制器和智能卡芯片的需求下降所致。
- 本季度來自於分立器件的銷售收入占總銷售收入的 27.2%，環比上升 4.4 個百分點。從絕對金額來看，本季度分立器件的銷售收入較上季度減少了 140 萬美元，主要由於一家美國客戶的需求減少所致。
- 本季度來自於邏輯及射頻的銷售收入占總銷售收入的 10.2%，環比下降 2.2 個百分點，主要由於一些日本和臺灣客戶需求下降所致。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零一五年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第四季度 % (未經審核)	二零一五年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 百分點
0.13μm 及以下	50,269	36.1%	63,616	36.9%	(13,347)	(0.8)
0.15μm 及 0.18μm	22,149	15.9%	29,629	17.2%	(7,480)	(1.3)
0.25μm	4,153	3.0%	6,491	3.8%	(2,338)	(0.8)
0.35μm 及以上	62,831	45.0%	72,621	42.1%	(9,790)	2.9
銷售收入總額	139,402	100.0%	172,357	100.0%	(32,955)	-

- 本季度來自於 0.13μm 及以下工藝技術節點產品的銷售收入占總銷售收入的 36.1%，環比下降 0.8 個百分點。從絕對金額來看，本季度該類別銷售收入比上季度減少了 1,330 萬美元，主要由於微控制器產品和智能卡芯片的需求下降所致。
- 本季度來自於 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點產品的銷售收入占總銷售收入的 15.9%，環比下降 1.3 個百分點，主要由於邏輯產品和微控制器產品的需求下降所致。
- 本季度來自於 0.35μm 及以上工藝技術節點產品的銷售收入占總銷售收入的 45.0%，環比上升 2.9 個百分點。從絕對金額來看，本季度該類別銷售收入比上季度減少了 990 萬美元，主要由於電源管理芯片的需求下降所致。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一五年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第四季度 % (未經審核)	二零一五年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 百分點
電子消費品	78,917	56.6%	100,551	58.3%	(21,634)	(1.7)
通訊	30,230	21.7%	36,630	21.3%	(6,400)	0.4
工業及汽車	19,569	14.0%	23,605	13.7%	(4,036)	0.3
計算機	10,685	7.7%	11,570	6.7%	(885)	1.0
銷售收入總額	139,402	100.0%	172,357	100.0%	(32,955)	-

- 電子消費品及通訊仍分別為我們第一及第二大終端市場分佈，本季度合計貢獻 78.3% 的銷售收入。
- 電子消費品本季度貢獻銷售收入 56.6%，環比下降 1.7 個百分點，主要由於智能卡芯片和電源管理芯片的需求下降所致。
- 通訊類產品本季度貢獻銷售收入 21.7%，環比上升 0.4 個百分點。從絕對金額來看，本季度通訊類產品銷售收入較上季度減少了 640 萬美元，主要由於智能卡芯片的需求下降所致。

產能⁵及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一五年 第四季度 (未經審核)	二零一五年 第三季度 (未經審核)	二零一四年 第四季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	56	52	50
2 號晶圓廠	50	45	39
3 號晶圓廠	40	40	40
總估計月產能	146	137	129
產能利用率	80.3%	90.4%	93.3%

- 由於產量下降，產能上升，以及工廠年度維護（一廠和三廠）等原因，產能利用率由上季度的 90.4% 下降至本季度的 80.3%。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一五年 第四季度 (未經審核)	二零一五年 第三季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第四季度 (未經審核)	同比
付運晶圓	332	384	(13.5)%	343	(3.2)%

- 本季度付運晶圓 332 仟片，環比下降 13.5%，主要由於客戶需求下降所致。

⁵ Wafers per month at the end of the period, calculated on a 30-day basis for comparison purposes.

經營開支分析

以千美元計	二零一五年 第四季度 (未經審核)	二零一五年 第三季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第四季度 (未經審核)	同比
銷售及分銷費用	2,215	1,688	31.2 %	2,085	6.2 %
管理費用 ⁶	27,753	26,344	5.3 %	23,960	15.8 %
經營開支	29,968	28,032	6.9 %	26,045	15.1 %

- 本季度經營開支 3,000 萬美元，較上季度的 2,800 萬美元上升了 6.9%，主要由於本期計提年終獎金所致。

其他收入淨額分析

以千美元計	二零一五年 第四季度 (未經審核)	二零一五年 第三季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第四季度 (未經審核)	同比
租金收入	3,280	3,264	0.5 %	3,695	(11.2)%
利息收入	1,631	2,329	(30.0)%	1,247	30.8 %
匯兌收益	1,798	4,470	(59.8)%	444	305.0 %
分佔一家聯營公司溢利(損失)	(783)	(668)	17.2 %	17	(4,705.9)%
財務費用	(1,669)	(1,894)	(11.9)%	(2,638)	(36.7)%
研發資助	9,361	-	100.0 %	603	1,452.4 %
其他	626	2,101	(70.2)%	(330)	(289.7)%
其他收入淨額	14,244	9,602	48.3 %	3,038	368.9 %

- 其他收入淨額 1,420 萬美元，環比增加 48.3%，主要由於本期獲得較多的研發資助及財務費用下降所致，部分被匯兌收益和利息收入下降的影響所抵消。

現金流量概要

以千美元計	二零一五年 第四季度 (未經審核)	二零一五年 第三季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第四季度 (未經審核)	同比
經營活動所得現金流量淨額	62,209	85,716	(27.4)%	89,987	(30.9)%
投資活動所得(用)現金流量淨額	78,276	22,342	250.4 %	(21,448)	(465.0)%
融資活動所得(用)現金流量淨額	(63,000)	(1,861)	3,285.3 %	235,834	(126.7)%
外匯匯率變動影響淨額	(1,016)	(7,162)	(85.8)%	1	(101,700.0)%
現金及現金等價物增加淨額	76,469	99,035	(22.8)%	304,374	(74.9)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 6,220 萬美元，環比減少 27.4%，主要由於上季度收回用於質押開立信用證的存款 4,140 萬美元所致，部分被本季度獲得研發資助的影響所抵消。

- 本季度投資活動所得現金流量淨額 7,830 萬美元，其中包括銀行理財產品到期收回 1.221 億美元，利息收入 260 萬美元，部分被設備投資支出 2,600 萬美元和新增定期存款 2,040 萬美元所抵消。

- 本季度融資活動所用現金流量淨額 6,300 萬美元，其中包括償還人民幣貸款 3.714 億元(約合 5,750 萬美元)，償還美元貸款 4,280 萬美元，償還銀行貸款利息 170 萬美元；同時，公司新借一筆人民幣貸款 2.530 億元(約合 3,900 萬美元)。

⁶管理費用包括確認為研發開支抵消項目的研發資助。

流動性概述

以千美元計	於十二月三十一日 二零一五年 (未經審核)	於九月三十日 二零一五年 (未經審核)
存貨	107,081	84,093
貿易應收款項及應收票據	103,822	121,962
預付款項、按金及其他應收款項	9,407	13,779
應收關聯方款項	25,282	33,450
其他金融資產	-	122,304
已抵押存款及定期存款	41,796	23,332
現金及現金等價物	510,441	433,972
流動資產總額	797,829	832,892
貿易應付款項	66,280	57,161
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	84,676	70,531
計息銀行借款	42,750	61,343
研發資助	57,526	57,980
應付關聯方款項	8,763	12,514
應付所得稅	21,576	20,253
流動負債總額	281,571	279,782
淨營運資金	516,258	553,110
速動比率	2.5x	2.7x
流動比率	2.8x	3.0x

- 存貨由上季度末的 8,410 萬美元上升至 1.071 億美元，主要由於存貨周轉減慢所致。
- 貿易應收款項及應收票據由上季度末的 1.220 億美元下降至 1.038 億美元，主要由於銷售收入下降所致。
- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 1,380 萬美元下降至 940 萬美元，主要由於對供應商預付款減少所致。
- 應收關聯方款項由上季度末的 3,350 萬元下降至 2,530 萬美元，主要由於來自關聯方的銷售收入下降所致。
- 其他金融資產由上季度末的 1.223 億美元下降至零美元，主要由於本季度末全部銀行理財產品均已到期收回所致。
- 已抵押存款及定期存款由上季度末的 2,330 萬美元上升至 4,180 萬美元，主要由於定期存款增加所致。
- 貿易應付款項由上季度末的 5,720 萬美元上升至 6,630 萬美元，主要由於對供應商的付款減少所致。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 7,050 萬美元上升至 8,470 萬美元，主要由於本季度計提年終獎金所致。
- 應付關聯方款項由上季度末的 1,250 萬美元下降至 880 萬美元，主要由於確認了二零一五年第四季度的關聯方房屋租金所致。
- 淨營運資金為 5.163 億美元，流動比率為 2.8；上季度末淨營運資金為 5.531 億美金，流動比率為 3.0。

資本結構

以千美元計	於十二月三十一日 二零一五年 (未經審核)	於九月三十日 二零一五年 (未經審核)
現金及現金等價物	510,441	433,972
已抵押存款及定期存款	41,796	23,332
其他金融資產	-	122,304
短期計息銀行借款	42,750	61,343
長期計息銀行借款	137,871	181,455
銀行借款總額	180,621	242,798
權益	1,490,528	1,499,476
資本負債比率 ⁷	(24.9)%	(22.5)%

資本開支概要

- 本季度資本開支為 2,600 萬美元，上季度為 4,220 萬美元。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com

⁷ (銀行借款 - 現金及現金等價物 - 已抵押存款及定期存款 - 其他金融資產) / 總權益

華虹半導體有限公司
簡明綜合損益表
(以千美元計, 除每股盈利和股數外)

	截至以下日期止三個月	
	於十二月三十一日 二零一五年 (未經審核)	於九月三十日 二零一五年 (未經審核)
銷售收入	139,402	172,357
銷售成本	(98,290)	(119,681)
毛利	41,112	52,676
其他收入及收益	16,696	12,164
銷售及分銷費用	(2,215)	(1,688)
管理費用	(27,753)	(26,344)
財務費用	(1,669)	(1,894)
分佔一家聯營公司溢利 (損失)	(783)	(668)
稅前溢利	25,388	34,246
所得稅開支	(4,522)	(4,015)
期內溢利	20,866	30,231
以下各方應佔利潤:		
母公司擁有人	20,866	30,231
非控股權益	-	-
持有人應佔每股盈利		
基本	0.02	0.03
攤薄	0.02	0.03
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,033,871,656	1,033,871,656
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,037,337,663	1,034,549,815

華虹半導體有限公司
簡明綜合損益表
(以千美元計, 除每股盈利和股數外)

	二零一五年 (未經審核)	二零一四年 (已審核)
銷售收入	650,131	664,586
銷售成本	(448,705)	(466,815)
毛利	201,426	197,771
其他收入及收益	42,717	23,886
銷售及分銷費用	-	1,127
管理費用	(7,292)	(7,206)
財務費用	(104,855)	(85,053)
其他費用	(9)	(2,433)
財務費用	(7,754)	(12,136)
分佔一家聯營公司溢利	840	4,856
稅前溢利	125,073	120,812
所得稅開支	(12,687)	(27,722)
年內溢利	112,386	93,090
以下各方應佔利潤:		
母公司擁有人	112,386	93,090
非控股權益	-	-
持有人應佔每股盈利		
基本	0.11	0.11
攤薄	0.11	0.11
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,033,871,656	853,421,114
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,034,920,190	853,421,114

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於十二月三十一日 二零一五年 (未經審核)	於九月三十日 二零一五年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一四年 (已經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	630,606	633,940	568,626
投資物業	180,484	184,237	191,533
預付土地租賃款項	22,120	22,753	24,194
無形資產	10,735	11,710	14,708
於聯營公司的投資	40,713	42,352	42,030
可供出售投資	217,214	221,731	230,512
長期預付款項	10,806	8,719	8,237
遞延稅項資產	4,692	6,598	9,191
非流動資產總額	1,117,370	1,132,040	1,089,031
流動資產			
存貨	107,081	84,093	93,988
貿易應收款項及應收票據	103,822	121,962	107,509
預付款項、按金及其他應收款項	9,407	13,779	7,007
應收關聯方款項	25,282	33,450	43,178
其他金融資產	-	122,304	-
已抵押存款及定期存款	41,796	23,332	2,583
現金及現金等價物	510,441	433,972	646,773
流動資產總額	797,829	832,892	901,038
流動負債			
貿易應付款項	66,280	57,161	63,532
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	84,676	70,531	72,310
計息銀行及其他借款	42,750	61,343	81,690
研發資助	57,526	57,980	63,885
應付關聯方款項	8,763	12,514	25,006
應付所得稅	21,576	20,253	23,148
流動負債總額	281,571	279,782	329,571
流動資產淨額	516,258	553,110	571,467
總資產減流動負債	1,633,628	1,685,150	1,660,498
非流動負債			
計息銀行及其他借款	137,871	181,455	183,031
遞延稅項負債	5,229	4,219	11,988
非流動負債總額	143,100	185,674	195,019
淨資產	1,490,528	1,499,476	1,465,479
權益和負債權益			
股本	1,550,164	1,550,164	1,550,164
儲備	(59,636)	(50,688)	(84,685)
權益總額	1,490,528	1,499,476	1,465,479

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月	
	於十二月三十一日 二零一五年 (未經審核)	於九月三十日 二零一五年 (未經審核)
經營活動所得現金流量		
稅前溢利	25,388	34,246
折舊及攤銷	19,247	22,038
應佔聯營公司溢利	783	668
營運資金的變動及其它	16,791	28,764
經營活動所得現金流量淨額	62,209	85,716
投資活動所得現金流量:		
購置物業、廠房及設備項目	(26,046)	(42,176)
其他投資活動所得的現金流量	104,322	64,518
投資活動所得現金流量淨額	78,276	22,342
融資活動所用現金流量:		
新增銀行貸款	38,961	-
償還銀行貸款	(100,226)	-
已付利息	(1,735)	(1,861)
融資活動所用現金流量淨額	(63,000)	(1,861)
現金及現金等價物減少淨額	77,485	106,197
外匯匯率變動影響淨額	(1,016)	(7,162)
期初現金及現金等價物	433,972	334,937
期末現金及現金等價物	510,441	433,972

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月	
	於十二月三十一日 二零一五年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一四年 (經審核)
經營活動所得現金流量		
稅前溢利	125,073	120,812
折舊及攤銷	79,048	84,488
應佔聯營公司溢利	(840)	(4,856)
營運資金的變動及其它	(28,434)	21,296
經營活動所得現金流量淨額	174,847	221,740
投資活動所用現金流量:		
購買物業、廠房及設備項目	(175,537)	(77,071)
其他投資活動所用的現金流量	(38,074)	(19,859)
投資活動所用現金流量淨額	(213,611)	(96,930)
融資活動所得(用)現金流量:		
發行股份所得收益	-	331,730
股份發行費用	-	(11,562)
新增銀行貸款	38,961	-
償還銀行貸款	(119,854)	(101,301)
已付利息	(7,800)	(12,136)
融資活動所得(用)現金流量淨額	(88,693)	206,731
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(127,457)	331,541
外匯匯率變動影響淨額	(8,875)	(1,813)
期初現金及現金等價物	646,773	317,045
期末現金及現金等價物	510,441	646,773

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

傅文彪(董事長)
王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波
馬玉川
森田隆之
葉峻

獨立非執行董事

張祖同
王桂壩太平紳士
葉龍堇

承董事會命
華虹半導體有限公司
傅文彪
董事長兼執行董事

中國 香港
二零一六年二月二日